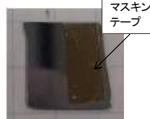
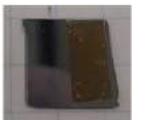
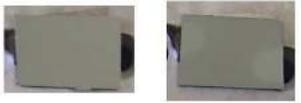
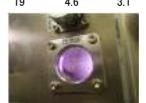
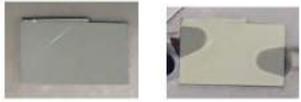
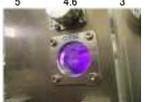
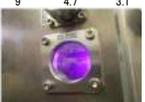


共通条件  
 ステージ回転 無  
 プリスパッタ 1分  
 成膜時間 10分

サンプル	ターゲット	排気ポンプ	成膜前圧力[Pa]	Ar [sccm]	成膜中圧力[Pa]	FWD [W]	REF [W]	成膜前	成膜後	備考	放電の様子				
無 (ステーション)	Ti	E2M1.5	2.5	1	6.6	100	0			成膜出来た。(目視)					
Si	Ti	E2M1.5	3	0.8	7.3	100	0			成膜出来た。(目視)					
Si	Ti	E2M1.5	3	1	10	100	0			成膜出来た。(目視)					
Si	Ti	E2M1.5	3	1.5	30	100	0			成膜出来ず。(目視)					
Si(1)	Al	E2M1.5	3	0.8	6.6	100	30			成膜出来ず。(目視)					
Si(2)	Al	E2M1.5	1.4	0.8	6.6	100	30			成膜出来ず。(目視)					
Si(3)	Al	E2M1.5	1.4	0.8	6.6	100	10			成膜出来ず。(目視) 上記の条件では、 反射が大きいため、 マスキングボックスの コンデンサを 700pF→500pFに変更					
Si	Al	RV8	0.76	4.7	7.1	100	12			成膜出来ず。(目視)	TIMER 1 圧力 7 Ar流量 - 	TIMER 3 圧力 7 Ar流量 - 	TIMER 5 圧力 7 Ar流量 - 	TIMER 7 圧力 6.9 Ar流量 - 	TIMER 9 圧力 6.9 Ar流量 4.7 
Si	Al	RV8	0.76	1.6	3.1	100	17			成膜出来た。(目視) 成膜後の左側にうすく成膜された。 基板押えの跡が確認できる。  右側は、マスクしていないが、 ポリイミドテープを張り付けていて、 剥がした後洗浄せずにセットした為、	TIMER 1 圧力 3.1 Ar流量 - 	TIMER 3 圧力 2.8 Ar流量 1.7 	TIMER 5 圧力 2.9 Ar流量 1.7 	TIMER 7 圧力 2.8 Ar流量 1.7 	TIMER 9 圧力 2.8 Ar流量 1.7 



Si 成膜時間 20分 再現性	Al	RV8	0.76	2.9	5	100	16		成膜出来た。(目視) 前回よりも膜が薄いように見える。 今回は放電の色が変化しなかった。 放電の色の違いは、膜厚のレートに関連していると推定。 膜厚のレートの関連しているようなので、 成膜時間を10分のまま、 RF FWD100W→200Wにする。	TIMER 1 圧力 5.8 Ar流量 3.1 	TIMER 8 圧力 4.8 Ar流量 3.1 	TIMER 9 圧力 4.7 Ar流量 3.1 	TIMER 10 圧力 4.6 Ar流量 3.1 	TIMER 19 圧力 4.6 Ar流量 3.1 
Si	Al	RV8	0.76	2.9	5	130	250		成膜出来た。(目視) ※ 放電開始時は、入力130W以上で反射が大き 設定できなかった。 5分経過後放電の色が変わり、 200W入力でき、反射波0となった、	TIMER 1 圧力 5 Ar流量 3.1 	TIMER 5 圧力 4.6 Ar流量 3 	TIMER 9 圧力 4.7 Ar流量 3.1 		
Si	Ti	RV8	0.76	2.9	5	200	0		成膜出来た。(目視)	TIMER 2 圧力 5.1 Ar流量 3.4 	TIMER 5 圧力 5.1 Ar流量 3.4 	放電の色が強く目に悪いので、 シャッターを少し開いて、 放電を観察した、		
Si	SiO <sub>2</sub>	RV8	0.76	2.9	5	200	1		成膜出来た。(目視) 成膜時間は20分。	TIMER 2 圧力 5 Ar流量 3 	TIMER 10 圧力 4.9 Ar流量 3 	TIMER 18 圧力 5 Ar流量 3 		

Si基板へAl、Ti、SiO<sub>2</sub>の成膜が出来ましたので、  
TMPなしRV8排気のみで成膜可能です。